

SEMI G88-0211

SPECIFICATION FOR TAPE FRAME FOR 450 mm WAFER

450mm ウェーハ用テープフレームの仕様

免責事項:この SEMI スタンダードは、投票により作成された英語版が正式なものであり、日本語版は日本の利用者各位の便宜のために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます。

本スタンダードは、global Assembly & Packaging Committee で技術的に承認されている。現版は 2010 年 12 月 21 日、global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2011 年 2 月に www.semiviews.org および www.semi.org で入手可能となる。

1 目的

1.1 本文書の目的は、ダイシングプロセスとダイボンディングプロセスの間、および、ウェーハの出荷と搬送に使用される 450mm ウェーハ用のテープフレーム仕様を標準化することである。

2 範囲

- 2.1 本スタンダードは、450mm ウェーハ用テープフレームに適用される。
- 2.2 本スタンダードは、450mm ウェーハのテープフレームのための寸法、機械特性、および測定方法を文書化する。
- 2.3 本スタンダードは、購買の際にテープフレームのための仕様書として使用することができる。

注意: このスタンダードおよび安全ガイドラインはその使用に関連した全ての安全問題を取り扱うことを意図していない。この文書の使用者は、その責任において、適切な安全および健康上実施すべき事柄を確立し、また使用前に法規制やその他の制限への適用性を判断するものである。

3 参照スタンダードおよび文書

- 3.1 ISO Standards¹

ISO13468-1 – Plastics – Determination of the total luminous transmittance of transparent materials – Part 1 : Single beam instrument

注意: 別途指示のない場合、引用された全ての文書は最新の出版バージョンである。

4 用語

- 4.1 定義

4.1.1 テープフレーム (*tape frame*) – ウェーハテープを貼り付けてウェーハを固定するための、リング状のフレーム。ダイシングプロセスとダイボンディングプロセスとの間、および、ウェーハの出荷と搬送に使用される。

4.1.2 ウェーハテープ (*wafer tape*) – ウェーハまたは切断されたチップを保持する接着性プラスチックテープ。

¹ International Organization for Standardization, ISO Central Secretariat, 1 rue de Varembe, Case postale 56, CH-1211 Geneva 20, Switzerland. Telephone: 41.22.749.01.11; Fax: 41.22.733.34.30; <http://www.iso.ch>

5 要求条件

5.1 寸法 — 図1および表1参照。

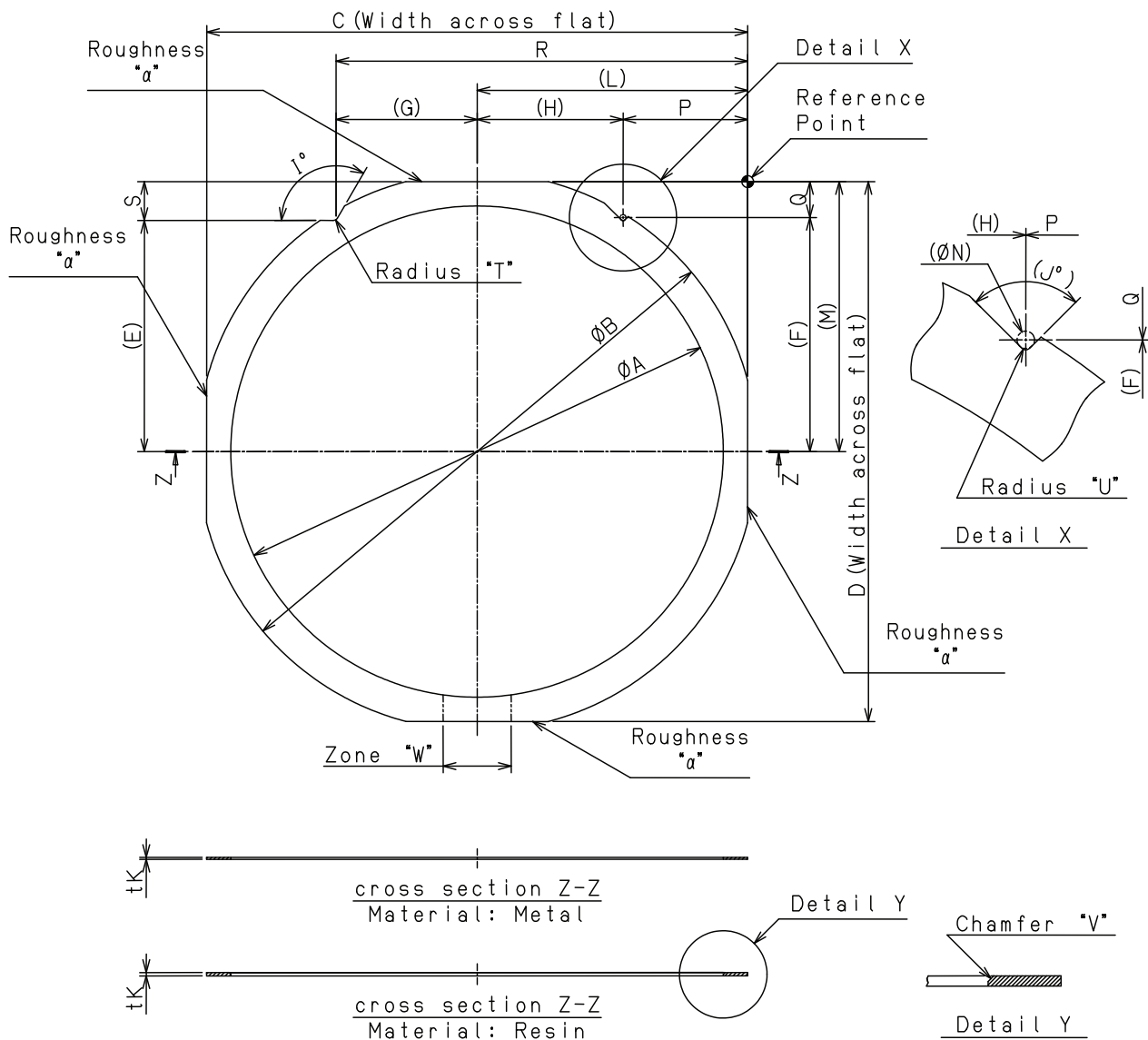


図1
450mm ウェーハ用 テープフレーム寸法（表面図，側面図）